



2026年5月19日

各 位

会社名 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
代表者名 代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫
(コード番号3652、東証グロース)
問合せ先 経営企画部長 吉田 幹夫
TEL 03-6454-0450

2026年3月期決算説明会書き起こしのお知らせ

2026年5月15日に開催しました「2026年3月期決算説明会」の書き起こしを公開しましたので、お知らせします。2026年3月期決算概要、2027年3月期通期業績予想、成長戦略・ビジョン等についてご説明していますので、ご参照ください。

【2026年3月期 決算説明会概要】

日時：2026年5月15日 16:30～17:20

説明者：代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫
経営企画部長 吉田 幹夫

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT



2026年3月期 決算説明会

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
2026年5月15日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

経営企画部長の吉田です。本日は当社の決算説明会にご参加いただきありがとうございます。

- 1 2026年3月期 決算説明
- 2 2027年3月期 通期業績予想
- 3 成長戦略・ビジョン

本日のアジェンダですが、2026年3月期決算と2027年3月期通期業績予想について私から説明し、その後、成長戦略ビジョンについて山本が説明します。

- 1 2026年3月期 決算説明
- 2 2027年3月期 通期業績予想
- 3 成長戦略・ビジョン

世界有数のグラフィックス IPベンダーとしての創業以来の経験・知見を活かし、近年は**アルゴリズム・ソフトウェアからハードウェア**、並びに**エッジからクラウド**に亘る一貫した AIサービスの提供により、お客様や社会の課題解決に貢献しています

| | | | |
|------|--|---|--|
| 会社名 | 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル (DMP) | IPコアライセンス事業 | |
| 設立 | 2002年7月 (2011年6月東証マザーズ上場, 2022年4月東証グロス移行) | ・AI/GPU IPコアライセンス ・AIソフトウェアライセンス | |
| 所在地 | 東京都中野区 | 製品事業 | |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫 | ・アミューズメント市場向け画像処理半導体 ・エッジAI半導体 ・協働ロボット向けビジョンシステム ・FA製品 (AMR本体/コンポーネント) ・モジュール | |
| 資本金 | 1,838百万円 | プロフェッショナルサービス事業 | |
| 従業員数 | 50名 (2026年4月1日現在) | ・AIアルゴリズム、コンピュータビジョンソフトウェア受託開発 ・FPGA/ボード受託開発 ・ロボティクス・セーフティに係る顧客製品・サービス開発サポート | |
| 特許数 | 36件 | | |

まず、決算内容のご説明の前に、当社 DMP の概要、強みについて簡単にご説明します。当社は 2002 年 7 月に大学発のベンチャー企業として発足以来、グラフィックス技術を核に事業を行い、GPU/IP が任天堂のゲーム機に採用されたり、アミューズメント市場向けに 2D/3D 統合グラフィックス LSI を投入し現在の収益の柱にするなど大きな成果を上げてきました。

近年は GPU と親和性の高い AI およびディープラーニング領域に進出し、アルゴリズム、ソフトウェアからハードウェア、並びにエッジからクラウドに至る一貫した開発体制、製品・サービスを提供できることを強みとして、DMP ならではの技術・製品・サービスでお客様の課題や社会課題の解決に貢献しています。

2026年3月期 - 業績ハイライト

- 次世代エッジAI半導体「Di1」の量産準備が完了し、顧客評価フェーズが着実に進捗
- ロボティクス/セーフティ分野(FA事業含む)は伸長し、事業ポートフォリオの多角化が進展
- アミューズメント分野では、特にパチスロの保通協検定適合率が低調に推移していることを主要因として、主力製品「RS1」の出荷が一時的に弱含みとなり、前期比で大きく減収

| 全社 | 事業別売上高 | 分野別売上高 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 売上高 | IPコアライセンス | ロボティクス / セーフティ |
| 2,432 百万円 (YoY※ △21.0%) | 139 百万円 (YoY +12%) | 281 百万円 (YoY 36%) |
| 経常利益 | 製品 | アミューズメント |
| △293 百万円 (YoY △561百万円) | 2,218 百万円 (YoY △22%) | 1,951 百万円 (YoY △30%) |
| | プロフェッショナルサービス | その他 |
| | 74 百万円 (YoY △24%) | 199 百万円 (YoY +120%) |

※ YoY (Year on Year) : 前年同期比

それでは、2026年3月期の業績ハイライトをお話します。

当期においては、次世代エッジ AI 半導体 Di1 の量産準備が完了し、顧客評価フェーズが着実に進捗し

ています。FA 事業を含むロボティクス・セーフティ分野は、前期比で 36%伸長し、事業ポートフォリオの多角化を進展させることができました。アミューズメント分野では、特にパチスロの保通協検定適合率が低調に推移していることを主な要因として、主力製品 RS1 の出荷が一時的に弱含みとなりました。

これを受け、全社の売上高についても 24 億 3200 万円と前期比マイナス 21.0%となりました。経常利益は前期比 5 億 6100 万円減益のマイナス 2 億 9300 万円となりました。

2026年3月期 決算ハイライト - 損益計算書



「Di1」の戦略投資(3億円)を実行、アミューズメント市場の調整局面影響もあり、営業赤字となるも、財務健全性維持

| (単位：百万円) | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 増減額 |
|----------|----------|----------|------|
| 売上高 | 3,077 | 2,432 | △644 |
| 営業利益 | 261 | △311 | △572 |
| 経常利益 | 267 | △293 | △561 |
| 当期純利益 | 153 | △327 | △481 |

- **戦略的投資の実行**：エッジAI半導体「Di1」の開発費3億円を計画通り支出、来期以降の成長に向けた基盤を確立
- **アミューズメント市場の調整による影響**：検定適合率低調を受け、画像処理半導体「RS1」出荷が抑制され前期比減収の主要因となった
- **利益面**：戦略投資負担と、売上減少により営業利益以下、各段階利益で赤字を計上

続きまして、損益計算書の概要です。

まず 2026 年 3 月期の決算は、非連結ベースです。これは、2025 年 9 月 30 日をもってその事業を終了した連結子会社 DMP ベトナムの出資持分 100%を、2026 年 2 月 9 日をもって第三者に譲渡したことにより、連結子会社が存在しないこととなったためです。

売上高については、先ほどのご説明の通り 6 億 4400 万円減収の 24 億 3200 万円となりました。売上の減少と、エッジ AI 半導体 Di1 の開発投資 3 億円を計画通りに行ったことによる研究開発費の増加により、営業利益はマイナス 3 億 1100 万円と前期から 5 億 7200 万円の減益、経常利益はマイナス、当期純利益はマイナス 3 億 2700 万円となりました。

● 事業別売上高

IPコアライセンス事業 139百万円 前年同期 124百万円

- AI-IPの初期ライセンス提供に加え、デジタル機器向けAI/GPUランニングロイヤリティ、ロボティクス・セーフティ分野におけるリカーリング収益、並びにメンテナンス・サポート収入等を計上

製品事業 2,218百万円 前年同期 2,855百万円

- RS1の量産出荷、Cambrianビジョンシステム、ドローン向けカメラモジュール、FA製品等の売上を計上
- アミューズメント市場の一時的調整により、RS1の量産出荷は前年同期比30%減

プロフェッショナルサービス事業 74百万円 前年同期 97百万円

- 半導体製造設備、安全運転支援、AMR向け受託開発サービス収入等を計上

● 分野別売上高

ロボティクス・セーフティ分野 281百万円 前年同期 207百万円

- ドライブレコーダー関連のリカーリング収益（ランニングロイヤリティ、サブスクリプションフィー）、メンテナンスサポート収入、Cambrianビジョンシステム、ドローン向けカメラモジュール、FA製品等の製品売上、並びに半導体製造装置向け、安全運転支援向け、AMR向けへのプロフェッショナルサービス売上を計上

アミューズメント分野 1,951百万円 前年同期 2,779百万円

- 主にRS1の量産出荷売上を計上

その他分野 199百万円 前年同期 90百万円

- IPコアライセンス事業におけるデジタル機器向けAI/GPUランニングロイヤリティ、メンテナンスサポート収入、一部製品売上等を計上

事業別・分野別の売上高を説明します。

IP コアライセンス事業はステレオビジョンの IP ライセンス収入などにより、前期比 1500 万円増収の 1 億 3900 万円となりました。

製品事業は、先ほどもお話ししたアミューズメント市場の一時的な調整により、RS1 の出荷が前年同期比 30%減となり、6 億 3700 万円減収の 22 億 1800 万円となりました。

プロフェッショナルサービス事業は、前期比 2300 万円減収の 7400 万円となりました。

続いて分野別の状況です。

ロボティクス・セーフティ分野は、ドライブレコーダー関連のリカーリング収益や半導体製造装置向けプロフェッショナルサービス売上などにより、前期比 7400 万円増収の 2 億 8100 万円となりました。

アミューズメント分野は前期比 8 億 2800 万円減収の 19 億 5100 万円となりました。

その他分野については、AI/や GPU IP のランニングロイヤリティ収入、一部製品売上等により前期比 1 億 900 万円増収の 1 億 9900 万円となりました。

自己資本比率は85.3%と高水準を維持 ～戦略的投資を可能にする強固な財務体質～

| (単位: 百万円) | 2025年 3月末 | 2026年 3月末 | 増減額 | 主な増減要因 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 流動資産 | 3,277 | 2,790 | △487 | 現預金 △714 原材料及び貯蔵品 +248 |
| 固定資産 | 800 | 1,041 | +240 | 有形固定資産 +27 無形固定資産 +36 投資有価証券 +171 |
| 資産合計 | 4,078 | 3,831 | △247 | |
| 流動負債 | 465 | 537 | +72 | 買掛金 +153 未払金 △59 未払消費税等 △6 未払法人税等 △19 |
| 固定負債 | 18 | 27 | +8 | |
| 負債合計 | 484 | 564 | +80 | |
| 純資産合計 | 3,594 | 3,266 | △328 | 利益剰余金 △327 |
| 負債・純資産合計 | 4,078 | 3,831 | △247 | |

続いて貸借対照表です。資産合計は 38 億 3100 万円で、前期末から 2 億 4700 万円減少しました。これは主に現預金が 7 億 1400 万円減少、原材料および貯蔵品が 2 億 4800 万円増加、投資有価証券が 1 億 7100 万円増加したことによるものです。負債合計は 5 億 6400 万円で前期末から 8000 万円増加しました。これは主に買掛金が 1 億 5300 万円増加、未払金が 5900 万円減少したことによるものです。純資産は当期純損失の計上により 3 億 2800 万円減少しましたが、自己資本比率は 85.3% で戦略的投資が可能な強固な財務体質を維持しています。

1 2026年3月期 決算説明

2 2027年3月期 通期業績予想

3 成長戦略・ビジョン

2027年3月期は、 収益・利益の改善と同時に、研究開発や人材の積極採用など戦略的投資を推進

| (単位：百万円) | 2026年3月期 通期実績 | 2027年3月期 | |
|----------|------------------|--------------|----------------|
| | | 通期予想 | 増減 |
| 売上高 | 2,432 | 3,640 | +1,207(+49.6%) |
| 営業利益 | △311 | 30 | +341 |
| 経常利益 | △293 | 45 | +338 |
| 当期純利益 | △327 | 30 | +357 |

- アミューズメント事業でのRS1の量産拡大・周辺ビジネスの取り込みによる安定的収益の確保とともに、成長領域であるエッジAI半導体事業およびロボティクス・セーフティ事業の拡大の取り組みにより、売上高は大幅増収を見込む
- エッジAI半導体 Di1の量産案件獲得への注力、ロボティクス・セーフティ事業でのDi1を統合した高付加価値ソリューションの開発・提供など、研究開発・人材採用を中心とした戦略的投資を継続実行
- 中期的には、アミューズメント市場の更なる取り込みに加え、エッジAI半導体事業とFA事業の2本の成長エンジンにより、収益拡大、企業価値向上を目指す

私のパートの最後に2027年3月期の業績予想について説明します。

2027年3月期では収益・利益の改善と同時に、研究開発や人材の積極採用などの戦略的投資を推進します。

売上高は、アミューズメント事業におけるRS1の量産拡大および周辺ビジネスの取り込みによる安定的収益の確保と、成長領域であるエッジAI半導体事業およびロボティクス・セーフティ事業の拡大の取り組みにより、これまでの過去最高額である2025年3月期の売上高30億7700万円を上回る36億4000万円を予想しています。

利益面では、研究開発や人材の積極採用などの戦略的投資を継続しますが、2026年3月期の赤字から脱却し、営業利益は3億4100万円増の3000万円、経常利益は4500万円、当期純利益は3000万円を予想しています。

私からのご説明は以上です。

- 1 2026年3月期 決算説明
- 2 2027年3月期 通期業績予想
- 3 成長戦略・ビジョン



PURPOSE
パーパス

Making the Image Intelligent

画像を智能化する

画像インテリジェンスの力で現実世界の問題を解決し、ステークホルダーに価値をもたらす革新的な製品とサービスを創造する

To develop cutting-edge products and services that leverage image intelligence to address practical challenges and deliver value to our stakeholders

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

12

続いて、山本から、我々の今後の戦略等についてお話しします。まず、当社のパーパスは、「画像を智能化する」、「Making the Image Intelligent」です。DMPのビジョン、あるいはAIの画像インテリジェンスの技術を使って、現実世界の問題を解決し、ステークホルダーに価値をもたらす革新的な製品サービスを提供するものです。

パラダイムシフト

生成AI: クラウド上でのテキスト・画像生成から現実世界を動かすAIへ

Physical AI: ロボティクス、ドローン等の物理的な「動き」への実装が急拡大

エッジAI需要を牽引する4つの鍵

REAL-TIME VISION

衝突回避や自律飛行はミリ秒単位の判断。

SECURITY

機密性の高い現場データを外部に出さない「エッジ完結型」。

TRUSTED SILICON

地政学リスクを背景とした日本発SoCへの期待。

EFFICIENCY

通信コスト削減と低消費電力での高度な推論の両立。



生成AIの波は現実世界（Physical）へ波及し、エッジ側でのリアルタイム処理と信頼性が不可欠な時代が到来

DMPの適合性

DMPはこれらの要求をすべて満たす「Di1」を軸に、Physical AIの中の重要な役割を担う

昨今よく話題にのぼるフィジカル AI について少し説明したいと思います。

まずこの右側の写真は、当社が数年前より発売しているフィジカル AI を使ったピッキングロボット Cambrian です。

昨今、生成 AI は、クラウド上でテキストあるいは画像を生成するものから、実際に現実世界を動かす AI に変化しています。これがフィジカル AI と呼ばれているものですが、それがロボティクスやドローンの物理的な動きに実装されることが急拡大しています。このフィジカル AI は、基本的にはエッジ側、例えばドローンやロボット、あるいは自動車等も含まれ、その上で実装されているものです。

それを牽引する大きな鍵としては 4 つあり、一つ目は REAL TIME VISION です。これはドローン等が衝突回避あるいは自律飛行する上で、ミリ秒単位の判断が必要になるため、リアルタイム性が非常に重要になります。

二つ目は SECURITY で、例えばエッジの中でデータやプライバシーを守っていくといったエッジ完結型のセキュリティの技術が重要です。

三つ目は TRUSTED SILICON とありますが、これは例えば地政学的なサプライチェーンの問題や半導体のバックドアの問題を回避した製品が求められており、日本製の半導体製品というのは非常に高く信頼されており、お客様からもグローバル規模で非常に期待が高いです。その中に DMP の半導体も含まれております。

4 つ目は EFFICIENCY で、通信コストや消費電力を抑えた上で、高度な AI の推論処理を両立させていくことが非常に重要です。

こういった要求を DMP の Di1 は満たしており、これを軸に DMP はフィジカル AI の中でこれから重要な役割を担っていくと考えています。

Graphics→Vision→AI→Physical AIという進化ストーリーを加速
現実世界を「見て、理解し、動かす」ためのEdge Intelligenceを実現

独自技術と統合力 (Integration Power)

01 GPU & NPU(AI)

低消費電力・高性能な画像処理とVision技術
業界初FP4対応による圧倒的な推論効率を実現

02 Stereo Vision

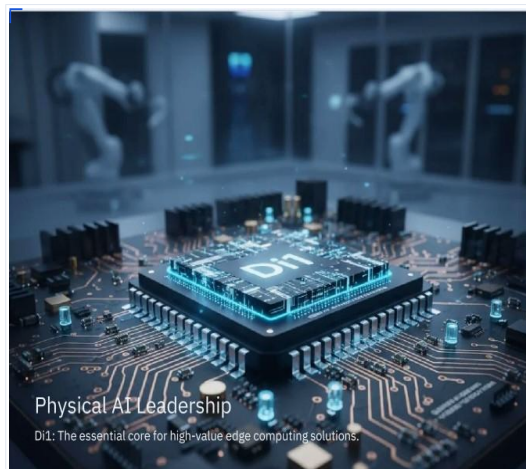
低消費電力で360°空間認識を実現するPhysical AI向け
Stereo Vision

03 Software

ZIA SAFE, ANPR (ナンバープレート認識) など、
実績のあるAIソフトウェア製品群

DMPの戦略的位置づけ

DMPはハード・ソフト・アルゴリズムを一体で提供し、Physical AIの
実装を最短距離で実現するプラットフォーム企業へ



「DMPはEdge Intelligence企業へ」とありますが、当社のグラフィックス、それからビジョン、AI、そしてフィジカル AI という進化のストーリーの中で今後、現実世界を実際に見て理解して動かすエッジインテリジェンスを実現していきます。

DMPの持つ独自のGPU、NPU技術、それから低消費電力で360度空間認識を実現するフィジカルAI向けのステレオビジョン技術、そしてこれらを動かすためのソフトウェア技術、例えばZIA SAFEやANPR(ナンバープレート認識)といった実績のあるソフトウェア製品、これらをハード、ソフト、アルゴリズム一体で供給することによって、DMPはフィジカルAIの実装を最短距離で実現するプラットフォーム企業になっていきます。

FY25ハイライト：技術実証から市場実装へ

FY25は、Di1の量産レベル完成と海外市場への進出により
開発ステージからビジネス実装へと大きく進んだ一年

1. テクノロジーの実証

- Di1量産レベル達成：CS評価を完了し「一発完動」を実現。
SoCとしての高い信頼性を証明。
- SDK整備：顧客が容易にAI実装を行える開発環境をアップデート。
導入障壁を大幅に低減。

2. グローバル戦略の第一歩としてインドでのビジネスが進展

MOU SIGNED

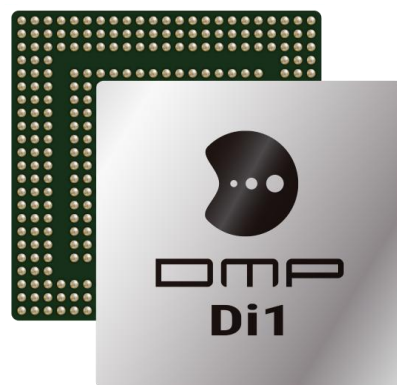
Sparsh CCTV

次世代エッジAIカメラの共同開発

STRATEGIC ALLIANCE

ideaForge

防衛・産業用途ドローンへのDi1搭載



2025年度のハイライトですが、技術実証から市場実装へということで、FY2025はDi1の量産レベルの完成と海外市場への進出により、開発ステージからビジネス実装へと大きく進んだ1年でした。

テクノロジーの実証面では、Di1 の量産レベルを達成し、さらにこの Di1 を動かす SDK (Software Development Kit) を提供することにより、お客様の導入障壁を大幅に低減しています。そして、市場実装面では、グローバル戦略の第一歩として、インドでのビジネスが大きく進展しており、後ほどもう少し詳しく説明しますが、インド最大手のカメラメーカーの Sparsh 社で Di1 を使った次世代 AI カメラの開発が始まっています。また、同じくインドの最大手のドローンメーカーの ideaForge 社でも防衛・産業用途ドローンへの Di1 の搭載が決まっています。

Di1の競争優位性： 選ばれる4つの理由



「AI + Vision + Stereo」の1チップ統合と、日本発のクリーンなサプライチェーンが 競合に対する優位性に

システム統合

ISP + NPU + ステレオビジョン + コーデックを1チップに統合。外部アクセラレータ不要で、基板の小型化とコスト削減を実現。

世界初* FP4対応の高効率

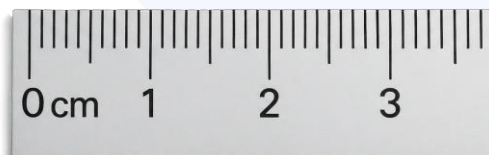
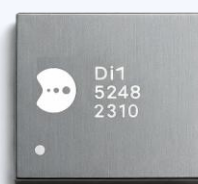
低メモリ・低電力で高速なAI推論を実現。バッテリー駆動のドローンやAMRにおいて、稼働時間の延長に直結する電力性能効率を提供。

360度全方位の「目」

4ch Stereo: 自社設計エンジンにより、LiDAR不要で高精度な3D距離測定が可能。軽量化とコストダウンの切り札。

高度なセキュリティーと信頼の「Made in Japan」

地政学リスクを回避した供給体制。Secure Boot、高度なデータ保護、及びブロックチェーンをサポート。



Di1 の競争優位性として、選ばれる 4 つの理由を説明します。一つ目はシステム統合です。これは AI、ビジョン、とステレオをワンチップに統合したものです。二つ目は世界初の FP4 (Floating Point 4 bit) の技術を使った非常に高効率な AI の処理性能です。三つ目は 360 度、全方位の目とありますが、LiDAR 等が不要になる高精度な 3D の距離を測定することが可能になっており、これがドローン等における軽量化とコストダウンにつながっています。4 つ目は、高度なセキュリティーと、先ほどトラステッドシリコンと申し上げましたが、信頼の Made In Japan の半導体、地政学的なリスクを回避した日本発のクリーンな供給体制、あるいはセキュアブートというセキュリティー技術やデータ保護、ブロックチェーンサポートといった非常に高いセキュリティー技術を搭載していることが競争力になっています。

クラウド依存からエッジ処理へ
インドのカメラ大手SparshがDi1で次世代CCTV市場を攻略

「Cloud AI → Edge AI」への潮流

通信遅延の解消、通信コストの劇的削減、プライバシー保護の観点から、カメラ端末側でのAI処理（エッジ解析）が世界的な標準へ。

高成長するインド市場：Sparsh CCTV協業

インド有力メーカーSparsh社と次世代エッジAIカメラを共同開発。量産を視野に試作開発が進行中。
初年度5万台、3年目には数十万台規模の出荷を目指す。

ANPR（自動ナンバープレート認識）ソリューション

スマートシティ、交通インフラ、駐車場管理、高速道路等での需要が急増。



実際の市場実装の例をご紹介します。一つ目は CCTV、これは監視カメラと言っても差し支えないと思いますが、監視カメラにおいて、現在、クラウド依存の監視カメラシステムからエッジでの処理への動きが加速しています。その中でインドの大手カメラベンダーである Sparsh 社で次世代の CCTV カメラを開発することが決まっています。この Sparsh はインドでも特に Make In India というポリシーの中で最も進んだメーカーと言われており、特に政府、公共機関系の非常に強いベンダーと言われております。その Sparsh 社で Di1 を使った新しいエッジ AI カメラを開発するということが決まっており、初年度で 5 万台、3 年目には数十万台の生産を目指すという目標で開発がスタートしています。また、ANPR（自動ナンバープレート認識）等の DMP のソフトウェアを Di1 に搭載し、スマートシティや交通インフラといった、特にインド等で需要が爆発的に増えている需要に対応していくことを行っています。

インドローン最大手 ideaForge社の次世代ドローンにDi1が採用される
ideaForgeのドローンの日本市場への展開を含めた包括的な提携

技術統合

ideaForgeのVTOLプラットフォームに、DMP Di1を搭載。
本体での高度な視覚センシングとリアルタイム処理を実現。

市場展開

- DMPがideaForge製ドローンの 日本国内における販売、デモンストレーション、アフターサービスを行う。
- 地域最適化：日本の法規制や顧客ニーズに合わせた機体カスタマイズを推進。



Di1が提供する価値

360度ステレオビジョン:
複雑な地形や過酷な環境下での自律飛行・障害物回避を実現

低消費電力:
長時間のミッション遂行を可能にする電力効率

Trusted Silicon:
地政学リスクを受けにくい「日本発SoC」の信頼性

次にドローン市場ですが、こちらでも、インドの最大手の ideaForge 社の次世代ドローンに Di1 が採用されることが決まっています。さらにこの提携においては、ideaForge 社の Di1 を搭載したドローンを含めた同社製のドローンを DMP が日本市場で展開する包括的な合意がなされています。これにより、ideaForge 社でまずは VTOL という垂直離着陸型のドローンに Di1 が搭載され、その後に他の機種に展開される予定になっていますが、それにより非常に高度な視覚センシングとリアルタイム処理を実現したドローンが開発されていきます。今後の市場展開として、DMP が ideaForge 社のドローンを日本国内において販売をすることも決まっています。また DMP は、日本の法制度や企業ニーズに合わせた機体カスタマイズも推進・展開していきます。このドローンにおける Di1 の提供価値は、先ほども申し上げた 360 度のステレオビジョンです。これにより、複雑な地形や過酷な環境下での自律飛行や障害物回避が実現できます。それから Di1 の特徴である低消費電力により、長時間のミッションが可能になります。

インドにおいて、特に現在、地政学的な理由から中国製の製品や部品を排除する動きが加速しており、特にドローンにおいては、全世界の約 70% のシェアを持つ DJI 製をインド製の製品に置き換える動きが加速しています。その中で Di1 が非常に有力なチップとして注目されており、インドの ideaForge 社における Di1 の採用につながっています。補足すると、インド以外にも現在台湾やヨーロッパのドローンのお客様が Di1 を使った量産品の開発に進んでいる状況になっています。

ドローン業界の変革期：エッジAIと地政学的要請



ドローンは単なる飛行カメラから、エッジAIによる自律的な「インテリジェントエージェント」へと進化

MARKET PROJECTION 2030 (※)

1,176 億ドル

業界を牽引する2つの潮流

01 エッジAIによる自律性の向上

機体上でのリアルタイム処理へ移行し、通信遅延を排除。
GPSの届かない環境下でも障害物回避やルート最適化が可能に。

02 サプライチェーンの信頼性

中国製からの置き換え需要が急増し、「信頼できる技術」へのシフトが加速。



(※) Next Move Strategy Consulting調べ

MAKING THE IMAGE INTELLIGENT

Copyright (C) Digital Media Professionals Inc. All Rights Reserved.

19

このドローン業界の変革は、今申し上げた地政学的な要因も非常に大きいですが、ドローンが単なるこれまでの飛行カメラから、AI による自律的なインテリジェント・エージェントへと進化しており、市場規模としては 2030 年の予測で約 1200 億ドル、日本円にして約 20 兆円の大きな市場になると言われています。この市場を牽引する要素としては、まずエッジ AI による自律性の向上です。機体上でのリアルタイム処理によって、例えば GPS の届かない環境下でも障害物回避やルート最適化が可能になること、あるいはサプライチェーンの信頼性といった点で、DJI 等中国製からの置き換え需要が急増し、その中で信頼できる技術へのシフトが加速しています。すなわち Di1 のようなチップに対する需要が加速していると言えます。

半導体工場や物流自動化の課題を、プロフェッショナルサービスを起点に解決
現場主導で高付加価値なAI実装を、標準パッケージ化し推進

- 物流自動化大手と連携し、半導体工場の搬送・物流自動化プロジェクトへ取り組み中。
- AIソフトウェア・ハードウェアの標準パッケージ化と量産対応システムへの展開を通じて、ストック型収益への転換を目指す。



Solution Package
カメラ x AI画像認識 x 組み込みソフトの標準パッケージ化

次に少し話のギアを変え、当社のプロフェッショナルサービスについてお話しします。

当社のプロフェッショナルサービスを使った半導体工場のフィジカル AI 実装が進んでいます。これは、国内の大手の半導体のウエハ搬送システムを作られているお客様と提携し、半導体工場の搬送物流自動化プロジェクトに取り組んでいます。この中で特に当社のプロフェッショナルサービスを起点として、現場主導で高付加価値の AI の実装を進め、カメラ、AI 画像認識、組み込みソフト、それを動かすシステムハードウェアをソリューションパッケージとし、標準パッケージ化して量産対応することによって、売り切り型からストック型収益の確立を目指しています。

FA事業の競争優位性と成長戦略

「部品単体」ではなく“AMRトータルソリューション”を展開
世界的に競争力のあるパートナーと連携し成長が期待されるフィジカルAI領域に投資し共に成長する

FY2025ハイライト：AMRソリューションがTier1メーカーに採用される。
2028年度に向けた量産ラインの採用も確定。

- 競争優位性
 - ・ 海外最先端FA製品のローカライズ展開で日本市場に最適化
 - ・ 国際安全規格ISO 3691-4 準拠へ対応（SEER）、本番導入を実現する信頼性
- 今後の展望
 - ・ DMPのAI製品やAI技術との相乗効果でフィジカル AI 領域のビジネスを加速
 - ・ idea Forge Drones製高性能ドローンをラインナップに加え広いニーズに対応



昨年開始した FA 事業も、まだ金額は大きくありませんが、順調に立ち上がっており、単体の部品ビジネスではなく、AMR のトータル展開をしています。その中で世界的に競争力のあるロボットメーカーSEER、

Kinco、Hinson といった企業と提携し、非常に競争力のあるロボットソリューションを展開しています。昨年のハイライトとしては、AMR のソリューションが国内の自動車の大手の Tier1 メーカーに採用されており、これが 2028 年から量産ラインにも採用されることが決まっています。当社の FA 製品の優位性は、まず海外の競争力のある FA 製品を日本市場向けにローカライズして展開していることです。それからこの製品は、国際安全規格・セーフティの規格である ISO3691-4 に準拠しており、これによってお客様の導入に対する信頼性が非常に高いという特徴があります。

今後の展望としましては、DMP の持つ AI 製品や AI 技術との相乗効果で、このロボット・FA 製品と組み合わせたフィジカル AI 領域のビジネスを加速していきます。また、この FA 製品のビジネスの中に、先ほどご紹介しました ideaForge 社のドローンをラインナップとして加え、より幅広い FA のニーズに対応していくことを行ってまいります。

開発ロードマップ：技術的優位性の継続的強化



より高度なPhysicalAI向け次世代IP群を開発、Di1後継製品への搭載と国内外特定用途向け半導体顧客向けにライセンスビジネスを展開

PROJECT 01 次世代 NPU IPの開発

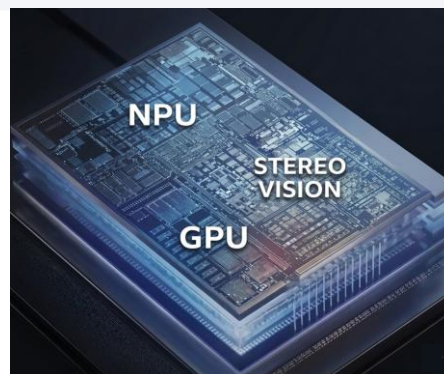
AI処理性能を大幅に向上し、より高度なAI推論と拡張性を備えたフラッグシップIP。国内外の大手複数社で評価が進行中。

PROJECT 02 次世代Stereo Vision Engine

現行世代比で大幅なステレオ性能向上を達成。大手海外顧客からライセンス受注済。

PROJECT 03 AIステレオキャリブレーション技術

物理的なステレオキャリブレーションをAIで代替。導入コストを削減し、AMRやドローンの量産普及を技術面から支える独自技術。



開発面では、当社の技術的優位性を継続的に強化していきます。特に高度なフィジカル AI 向けの次世代 IP の開発を行い、Di1 の後継製品に搭載するほか、国内外の特定用途向け半導体のお客様向けに IP ライセンスビジネスを展開していきます。

まずは次世代 NPU、AI プロセッサの開発で、現在の当社の AI プロセッサである A3000V2 に対して大幅に性能を向上させたものをフラッグシップ IP として提供していきます。既に国内外の大手のお客様で評価が進行しています。

また、次世代のステレオビジョン技術、このステレオビジョン技術も大きく性能を向上させ、FY 2025 の中で大手の海外のお客様にご採用いただいています。

さらに新しい技術として、「AI ステレオキャリブレーション技術」とありますが、ステレオビジョンは 2 つのカメラを使って距離を測る技術です。このカメラの機械的な誤差によって生じるステレオの誤差を AI を使ってキャリブレーションする技術を開発しており、これによりステレオビジョンの生産や導入コストを削減していくことに取り組んでいます。今後の当社の非常に強い技術になっていくと考えています。

2026年6月 東京流通センター内に開設。単なる展示場ではなくPhysical AI実装拠点として機能

■ 実機デモによる「体験型」提案

FA製品、AMR、ドローン、エッジAIカメラの稼働展示
課題解決を具体化

■ パートナー、顧客企業との共同検証、トレーニング

SEERやKinco等とDMP技術の統合
エコシステム全体の力を示すショーケース

■ アクセス

羽田空港近接の立地を活かし、顧客・パートナーとの連携強化



東京ロボティクスイノベーションセンター（完成イメージ図）

本日午後 4 時にプレスリリースしていますが、DMP の東京ロボティクス・イノベーションセンターを開設します。2026 年 6 月に東京流通センターの中に開設し、単なるショールームではなく、フィジカル AI の実装拠点として展開していきたいと考えています。ここでは、実機デモ、AMR あるいはドローン、AI カメラの稼働展示を行い、体験型でお客様に課題解決を具体化していただく場としていきたいです。またパートナーや顧客企業との共同検証やトレーニングの場として、当社のエコシステム全体の力を示すショーケースにしていきたいです。羽田空港近接の立地を活かし、お客様やパートナーとの連携をさらに強化していきたいと考えています。

収益モデルの進化： 持続的な企業価値向上に向けて

SoCを核とした「ソフト・サービス・ストック型」への進化と、ソリューションビジネスの強化で、収益の最大化と持続的な成長を実現する。

| | | |
|--|---|--|
| <p>01 SoCを起点とした付加価値の拡大</p> <p>SoCを顧客接点のフック（起点）とし、その上位レイヤーであるモジュール、ソフトウェアへと提供範囲を広げます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 提供レイヤーの垂直統合 IPライセンスの高度化 | <p>02 収益の最大化とストック型への転換</p> <p>ソフトウェアとサービスを組み合わせ、従来の売り切り型から継続的な利益を生む「ストック型」へとシフトします。</p> <ul style="list-style-type: none"> リカーリング収益の基盤構築 高利益率ソフトウェアの展開 | <p>03 ソリューションビジネスの強化</p> <p>テクノロジー製品・サービスとFA製品を融合させ、顧客課題を解決する包括的価値を提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> FA製品×テクノロジーの融合 顧客中心のエコシステム構築 |
|--|---|--|

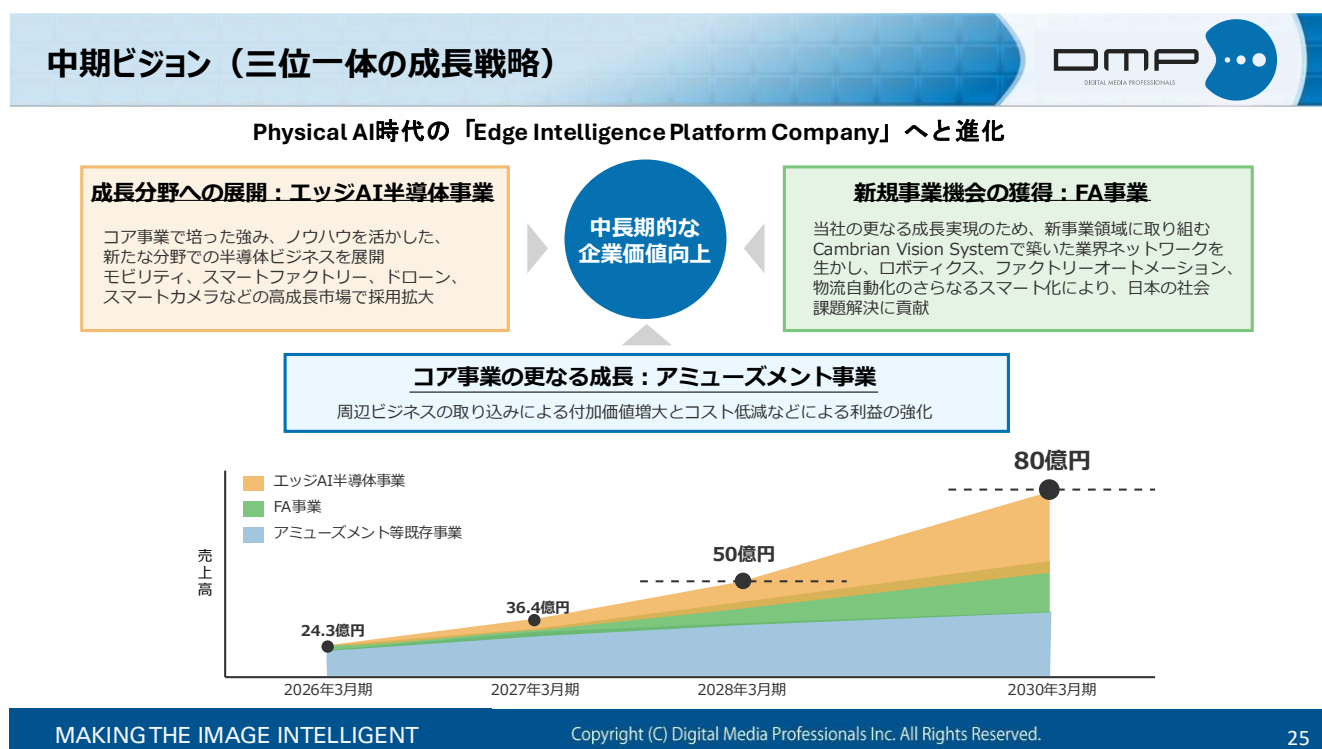
当社の収益モデルについて少しお話ししたいと思います。

収益モデルの進化、持続的な企業価値向上に向けてとありますが、当社の SoC、Di1、あるいはその後継チップを核としたソフト・サービス・ストック型ビジネスモデルに進化させることによって、ソリューションビジネスを強

化して、収益の最大化、持続的な成長を実現するということです。

まず、SoC を一つのフックとして、その上位レイヤーのソフトウェア、あるいはモジュールを構築することによって、垂直統合型で非常に付加価値の高い IP ライセンスビジネスも含めたビジネスを展開していくことです。当社はこれまでのビジネスの中で、実際にソフトウェアだけ、あるいはハードウェアだけのビジネスではなく、この 2 つを組み合わせることによって非常に高い価値が生まれることを実践しており、それを今回のロボット向けの SoC の分野でも展開していきます。

それから、ソフトウェアとサービスを組み合わせることによって、従来の売り切り型のビジネスから継続的な利益の獲得するストック型、例えばソフトウェアの機能アップグレードによる課金やメンテナンスといった持続的なストック型のビジネスを展開していきます。さらに、テクノロジー製品やサービス、それと先ほど説明した FA 製品を融合させることによって、お客様の課題を解決する包括的な価値を提供していくことを考えています。これにより今後、収益のさらなる最大化と持続的な成長を実現することを考えています。



中期ビジョンです。

こちらはこれまで説明してきた内容と変わりありませんが、当社のコアビジネスであるアミューズメントビジネスにその周辺ビジネスも取り込み、付加価値を上げることによって利益の最大化を図っていきます。それに加え、エッジ AI 半導体といった成長分野への展開、そして FA 製品のような新規分野にも参入していきます。こういった 3 つの要素を三位一体として、中長期的な企業価値の向上、そしてその中で、フィジカル AI 時代の Edge Intelligence Platform Company に進展していくことをやってまいります。中期の売上目標としましては、2028 年度 50 億円、それから 2030 年度 80 億円という目標は維持しています。



最後になりますが、DMPは Making the Image Intelligent のパーパスのもとに、フィジカル AI 時代の Edge Intelligence Platform Company と進化し、さらに持続的な成長を実現してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。



<お問い合わせ先>

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル 経営企画部

TEL:03-6454-0450

URL: <https://www.dmprof.com/jp/ir/>

- 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。
- 本資料は、弊社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、弊社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。本資料に全面的に依拠した投資等の判断は差し控え願います。

[質疑応答]

Q1 : iCatch Technology 社が Japan Drone 2026 において、AI ビジョン SoC V9 を用いたドローンロボット向けの AI ビジョンソリューションを展示予定と発表しています。御社の Di1 は iCatch 社との協業により展開されているものと理解していますが、iCatch 社が展開する V9 と御社の Di1 の関係性について、可能な範囲でご説明いただけますでしょうか。

A1：Di1 は DMP の製品ですが、これを共同開発している iCatch 社は V9 という製品名で台湾において販売しているという関係です。Di1 の開発においては、iCatch 社の ISP と呼ばれる Image Signal Processor といった画像の部分に関する技術等を導入しており、同技術と当社の AI プロセッサ、あるいはステレオビジョンのプロセッサ、それから GPU を統合して作っているチップという位置づけになります。

Q2：V9 ブランドでの展開・販売活動が進む場合、御社の Di1 の関連売上にはどのような形で寄与する想定でしょうか。例えば、チップ販売、ライセンス収入、開発支援、技術サポート収入など、収益化の形態について可能な範囲でご説明ください。

A2：先ほどのご回答でも申し上げましたが、Di1 のチップには iCatch 社の技術、当社の技術が統合されています。この Di1 を iCatch 社が V9 として販売した場合には、詳細については説明を控えますが、2 社の間でいわゆるレベニューシェアリングモデル、売上のシェアリングモデルを作っており、それによって両社に収益が上がるような形をとっております。

Q3：今回の Japan Drone 2026 での展示は、当社が重点領域として掲げるドローン・ロボティクス分野での事業展開にどのような意味を持つと捉えているのか、今後の商談、量産化に向けた進捗感も含めてご説明いただけますでしょうか。

A3：来月行われる Japan Drone 2026 において、iCatch 社がブースを出してそこで V9 を展示する予定ですが、V9 には iCatch 社製の ISP が搭載されており、そこが iCatch 社の持つ強みです。今回の Japan Drone 2026 における V9 の展示は、この iCatch 社のコアエキスパティーズである ISP の部分に焦点を当てた展示をする予定です。当社は AI、GPU、あるいはステレオビジョンといった技術を開発・提供しています。iCatch 社が行う V9 の展示においては、どちらかといえば ISP にフォーカスします。当社が Di1 を展示する場合は AI のユースケースが中心になります。ただ、事業展開する領域である監視カメラやドローンといったものは、お互いに共通の市場として捉えて展開してまいります。

Q4：Di1 の量産出荷は前期の第 4 四半期に行われたのか。

A4：Di1 は先ほどの説明の中でもあったように、実際の量産対応は昨年 4Q で完了しており、量産品の出荷体制はできています。ただ、実際の量産品出荷は、例えばインドの Sparsh 社、あるいは ideaForge 社、台湾のお客様、あるいは日本国内のお客様も開発を始めていますが、各お客様の量産スケジュールに則って開始されていく予定になっています。

Q5：2027 年 3 月期の Di1 の売上はどの程度想定をしているのでしょうか。また、売上利益予想に ideaForge 社のドローンの販売が含まれているのでしょうか。

A5：インドで開発が進んでいますので、Di1 は早ければ 2027 年 3 月期からの売上計上になるかと思っています。ただ、現時点では、それほど大きなボリュームを先ほどの予想の中には含めていません。

もう一点、ideaForge 社のドローンの販売について計画に入っているか、とのご質問に対する回答ですが、先ほど説明した 2027 年 3 月期の計画には織り込まれていません。こちらは販売体制やサポート体制が整い次第、拡販活動を開始する見通しになっていますので、開始したタイミングで売上損益にどの程度の影響があるか見通しを立て、必要な開示を行っていく状況です。

Q6：中期経営計画は今回出されないのでしょうか。大まかで構わないので、Di1 の今後の売上規模感を教えていただきたいです。

A6：中期経営計画は、昨年中期中期ビジョンとして公表しております。2028年3月期の売上高50億円、2030年3月期の売上高80億円、こちらの達成に向け活動していくことになっていきますので、改めて中期経営計画を公表する予定はございません。Di1 がどの程度2030年3月期にのってくるかですが、Di1 を含むエッジ AI 関連の売上で30%ぐらいを目指していきたいと考えています。

Q7：Di1 の顧客評価フェーズが進捗しているということですが、おおよそ何社程度が評価中なのでしょうか。

A7：当社はDi1 の開発キットを販売しており、現在、その開発キットを評価している会社の数は40社以上ですので、その中から実際に量産のお客様が出てくると考えています。

Q8：売上のビジョンは理解しましたが、利益はどの程度見込まれるのでしょうか。

A8：当社は研究開発型企業のため一定の研究開発費を每期使っていかなければいけませんし、また優秀な人材の確保の投資的な費用の使い方をしていけないといけません。この部分が当社にとっての投資となりますので、売上と投資のバランスを取りながら、PL についてもコントロールしていくことを考えています。利益の金額について具体的なところは申し上げづらいですが、営業利益で言うと、今期3000万円ですが、こちらは億円単位の利益を、早いタイミングで安定的に計上できるようなポートフォリオを築いていかなければいけません。

Q9：昨年、今期、新規でDi1 が採用される顧客が決定しているということでしたが、対象の顧客はSparsh社ということでよろしいでしょうか。

A9：はい、今、我々が公表できる範囲では、Sparsh社あるいはideaForge社がありますが、それ以外にも公表できていないお客様もいらっしゃいますので、それも含めてご理解いただければと思います。

Q10：先ほど台湾とヨーロッパのドローン企業ともタイアップしているというお話がありましたが、どれぐらいの規模の企業とタイアップされておられますか。

A10：はい、あまり具体的なお話はできませんが、台湾とヨーロッパの会社様で、いずれも防衛産業に深く関与されている会社様ですので、それなりの規模のお客様と理解しております。

Q11：今回の成長戦略では、Sparsh 向けの初年度5万台、3年目には数十万台の規模の出荷を目指す。また、ideaForge社のドローンについては、日本国内では販売やアフターサービス等をDMPが担うことが示されています。これらの案件について、2027年3月期の売上高36億4000万円のどの程度織り込まれているのでしょうか。また、それぞれの量産、それから販売会社の方式と、DMP側の収益形態がDi1の単体なのか、それともモジュール・ソフトウェアライセンスの販売、バンドルを含むものなのか、可能な範囲で教えてください。

A11：Sparsh社に関しては、公表したプレスリリースに記載のMOUの内容にあるとおり、6ヶ月以内に量産プロトタイプを完成して、それ以降量産に入ることを考えています。ビジネスモデルに関しては、まだ詳細は

決まっていない状況ですが、まずは当社の Di1 をチップのみならず、SoM (System on Module) として、より価値の高い形で提供することと、例えば Sparsh 社の場合、Di1 のユースケースとして当社の ANPR (自動ナンバープレート認識) や安全運転支援 ZIA SAFE といったソフトウェアのライセンスが含まれる可能性があります。

2027 年 3 月期の業績予想への織り込みの状況ですが、どのようなビジネスモデル、我々が提供できる部分がチップなのかモジュールなのかによっても大きく変わってきます。現時点では新たな製品の開発段階にあるため、全く織り込まない訳にはいきませんが、Di1 については比較的保守的に考え、一定程度 2027 年 3 月期の売上として予測しています。モジュール等の付加価値が高い形態での提供ができる場合には、伸び代があるものと考えています。

以上